

• 복리후생



글로벌 역량 강화

화상 및 전화 외국어, 외국어 Intensive 과정
사내 TOEIC, JPT 시험, 직무 교육 등



경력개발 프로그램 및 보상 제도

해외파견 등 글로벌 업무 경험, CDP(직무순환제도) 운영, 개인별
업무관리목표(MBO)를 통한 코칭과 성과에 따른 합리적인 보상



금융 지원

사내 세마을금고 입점, 주택자금, 생활안정자금, 경조금, 자녀
장학금 지원 등



의료 지원

건강관리실, 근골격계센터, 전문 심리상담실, 종합검진지원
의사방문 및 무료 진료상담 실시



인프라 지원

사내 카페테리아 및 복카페 운영, 기숙사지원, 사내 어린이집 운영
피트니스 클럽 운영, 사업장 별 셔틀버스 운행, 회사 콘도 지원



[고용노동부]
“일자리 창출 유공 표창”

[고용노동부]
“대한민국 일자리 으뜸기업 선정”

[산업통상자원부]
“무역의 날 20억불 수출의 탑 수상”

[고용노동부]
“장애인 고용 우수 사업주”

[한국장애인고용공단]
“트루컴퍼니(장애인고용 신뢰기업) 금상”



인재경영 | 기술혁신 | 고객지향 | 상생경영

엠코코리아
종합 QR코드



#국내1위

#반도체패키징&테스트

#Since1968

#나스닥상장



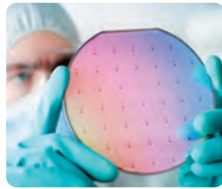
Enabling the Future

엠코코리아



최초에서 최고로 Global OSAT Leader

앰코테크놀로지코리아(주)(이하 앰코코리아)
는 1968년 한국 기업 **최초**로 반도체 사업에
착수한 아남산업이 그 전신입니다.



또한, **반도체 100년 기업**으로의 도약을 위해
인천 송도에 세계 최고 수준의 R&D센터와
최첨단 반도체 패키징 생산라인을 구축하며,
전 세계 11개국 30,000여명의 임직원과 함께 세계시장 점유율을 1위로
끌어올릴 준비를 하고있습니다.



특히, 4차 산업혁명으로 인해 반도체 패키징
시장의 경쟁이 치열해지면서 앰코코리아는
글로벌 경영 환경을 갖추고, 무결점 품질 등
차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

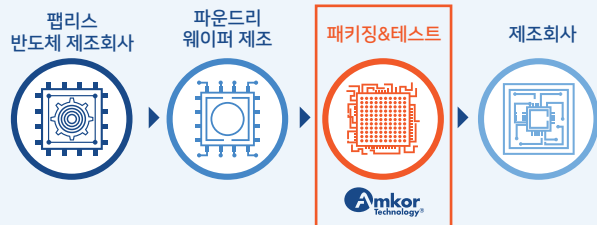
앰코코리아는 **적극적인 우수인재 채용**을 통해
이러한 경쟁력을 더욱 강화하고 **회사와 임직원의
동반성장**을 이끌고 있습니다.

OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly & Test)

반도체 산업은 간략하게 반도체를 설계하는 Fabless, 설계된 반도체를
생산하는 Foundry, 생산된 웨이퍼를 **패키징하고 테스트**하는 OSAT으로
구분됩니다.

앰코코리아는 반도체 후공정으로 불리는 **OSAT 시장에서 세계 최고의
기술력**을 바탕으로 미래를 대비한 핵심 Advanced packaging 기술 -
Heterogeneous & 3D Integration, System in Package, RF Module
and System, Advanced logic, and RF test, 5G antenna, Automotive
분야에서 **시장을 선도**하고 있습니다.

특히, 반도체 미세화에 따라 반도체 칩과 회로의 효율적인 배열, 적층
방식의 개선을 통한 다기능 고집적 구현의 중요성은 계속해서 커져가고
있으며, **Global OSAT Leader**인 앰코코리아는 **반도체 후공정 기술
발전**을 **선도**하고 있습니다. 앰코코리아에 입사한다면 **Global 기업**의
구성원으로서 미국, 유럽, 아시아 등 다양한 국가의 사람들과 일하게 되고
해외파견 기회도 얻을 수 있습니다.



Global Amkor



국내사업장

부평사업장(K3)	광주사업장(K4)	송도사업장(K5)
면적 : 13,223m (4,000평)	면적 : 439,669m (133,000평)	면적 : 185,689m (56,000평)
• TEST • Dropship	• Assembly • Wafer Bumping	• Global R&D Center • Assembly • TEST

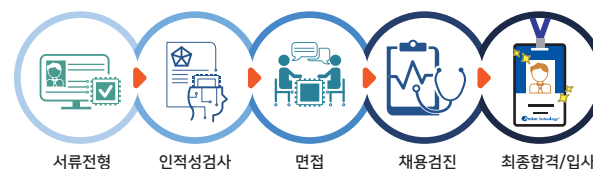
지원방법

앰코코리아 채용 홈페이지
(<https://amkor.recruiter.co.kr/>)에서
온라인 지원

앰코코리아
종합 QR코드



전형절차



*각 전형절차는 변경될 수 있으므로, 실제 입사지원 시 채용공고에서 확인

주요직무소개

직무	업무내용	관련전공
R&D	- 신규 제품개발 및 공정 관련 개발업무 - 고객의 Project 수행 및 기술적 대응	공학, 자연계열
Process Engineer (PE)	- 반도체 Package 생산라인 최적화 공정 구축 - 고객요청을 실현하기 위한 기술지원 및 공정설계	공학, 자연계열
TEST Engineer (TE)	- 반도체 디바이스 양산 TEST 지원 - TEST 환경 개발 및 신기술 도입	공학, 자연계열 (전기, 전자 관련 우대)
Quality Engineer (QE)	- 품질보증(품질 Issue 대응 및 예방) - 원자재 품질관리 - 신뢰성 분석	공학, 자연계열
생산기획 (IE)	- Capacity Planning - System & Data Analysis - 표준 설정 및 공정 관리화	전공무관 (산업공학 관련 우대)
고객만족 (PCS)	- 제조, 물류, 고객 Coordination - Production Control - 고객관리 및 Communication	전공무관 (외국어 우수자 우대)
구 매	- Substrate(PCB) 및 Other Direct Material (ODM) 구매, 조달 - Substrate, ODM 시장조사 - PO Planning 및 납기관리 - 가격협상과 신규업체 발굴 등 원가경쟁력 확보	전공무관 (외국어 우수자 우대)
자동화	- 공장자동화에 필요한 장비 등 SW 개발	컴퓨터공학, 시스템공학 (장비자동화 SW 활용 가능자 우대)
제조장비직 (Maint)	- 제조장비 유지 및 보수관리 - 공정품질 및 Yield 향상 - 프로세스 개선 및 장비가동률 향상	전문학사 이공계열 (전기, 전자, 기계 관련 우대)
제조직 (Operator)	- 반도체 패키징 및 제품생산 - 제품검사 및 품질검수 - 컴퓨터를 활용한 장비조작 등 업무	고졸 이상 전공무관